

中国半导体行业协会 中国电子材料行业协会 中国电子专用设备工业协会 中国电子报社

关于开展“第十四届（2019年度） 中国半导体创新产品和技术项目”评选活动的通知

会员单位及有关单位：

“中国半导体创新产品和技术项目”评选活动开展以来，得到业界的一致好评，对宣传和推广我国半导体产品和技术创新成果，加快创新成果产业化起到了积极作用。今年中国半导体行业协会、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社将继续联合举办“第十四届（2019年度）中国半导体创新产品和技术”评选活动，有关事项通知如下。

一、评选范围和条件

评选范围为半导体产业的创新产品和创新技术，包括集成电路、分立器件(包括半导体功率器件及模块、光电器件)、MEMS、半导体设备和仪器、半导体专用材料。

评选条件如下：

1、产品或技术的研发主体是在中国注册的企业或事业单位，主要研发工作在中国内地完成；

2、产品或技术拥有自主知识产权，具有创新性和先进性；

3、产品或技术已经得到实际应用，在产业化方面已取得一定进展；

4、产品或技术在国家有关部门受理或授权的相关专利时间在2017-2019年度；

5、已被评为“中国半导体创新产品和技术项目”的产品和技术不再参评。

二、评选步骤与办法

“第十四届（2019年度）中国半导体创新产品和技术项目”评选活动程序，按推报候选产品或技术、确定候选项目、投票评选、颁奖典礼和媒体宣传等五个步骤进行。

1、候选产品或技术的申报及推报

会员单位可以自荐本单位产品或技术参选；非协会会员单位可由中国半导体行业协会（含协会各分会）、中国电子材料行业协会、中国电子专用设备工业协会、中国电子报社或地方半导体（集成电路）行业协会推荐。

2、确定候选产品或技术

评委会秘书处对所有推报项目的材料进行审核、整理、汇总，将符合推报要求的产品或技术项目提交评委会。

评委会根据推报项目的具体情况，综合考虑评选条件的要求，确定最终的候选产品与技术。

3、投票评选

评委会召开评审会，听取秘书处对候选产品情况的说明；审看候选产品相关背景资料；对候选产品或技术进行讨论和评审，进行无记名投票。

当选产品或技术需获得到会评委三分之二以上(含三分之二)的票数。

4、颁奖典礼

主办方拟定于2020年4月，在“2020年世界半导体大会（原：中国半导体市场年会）”上举行颁奖典礼。

三、活动宣传

主办单位对获奖产品和技术以报告形式报送发改委、工业和信息化部、商务部、科技部、财政部等部委的相关司局。《中国电子报》、《中国集成电路》和《中国半导体行业信息网》对评选活动和获奖产品及技术进行专题报道。

四、评选材料申报方式和报名截止时间

1、申报材料采取电子版（申报表）与纸质材料并行申报方式。

2、纸质材料包括：申报表（附件）、产品或技术鉴定、验收和评价报告，专利受理或授权证书复印件，布图保护登记证书复印件，产品或

技术的用户报告（尽量提供），产品照片，产品商标。纸质版材料一式二份，简单装订成册。

3、报名截止时间：2020年1月20日

纸质文件邮寄：北京海淀区万寿路27号电子大厦316室(100846)

联系人：白洁 010-68207275 13501096021

陈文 010-68208591 18611439985

电子版申报表(附件)发送至：bj@csia.net.cn;chenwen@csia.net.cn

4、电子版申报表下载：www.csia.net.cn

五、评委会秘书处联系方式

单位：中国半导体行业协会

联系人：陈文

地址：北京市海淀区万寿路27号电子大厦316室（100846）

电话：010-68208591

邮件：chenwen@csia.net.cn

单位：中国电子材料行业协会

联系人：袁桐

地址：北京市朝阳区胜古中路2号院5号楼金基业大厦711/716室(100029)

电话：010-64498802

邮件：yuantong@c-e-m.com

单位：中国电子专用设备工业协会

联系人：金存忠

地址：北京市海淀区复兴路49号A座208室（100036）

电话：010-68860519

邮件：cepea@163.com

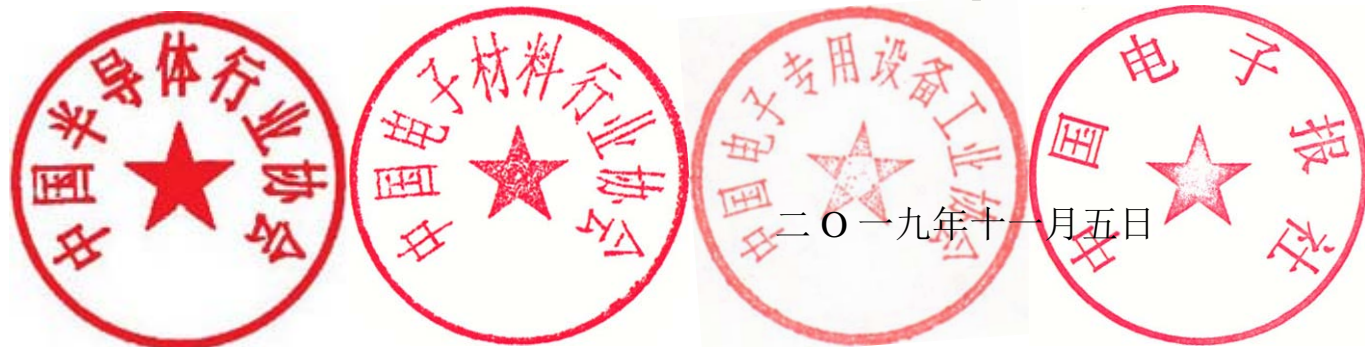
单位：中国电子报

联系人：任爱青

地址：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦8层（100048）

电话：010-88558879

邮件：renaq@cena.com.cn



附件：

第十四届（2019 年度） 中国半导体创新产品和技术项目评选申报表

单位名称		注册地	
地址		邮编	
网址			
法人代表	姓名		职务
	电话		传真
	手机		电子邮件
联系人	姓名		职务
	电话		传真
	手机		电子邮件
产品名称和型号 或技术名称：			
产品或技术类型（请在右边的“□”内打“√”）： 集成电路产品 <input type="checkbox"/> 半导体功率器件及模块 <input type="checkbox"/> 光电器件 <input type="checkbox"/> MEMS <input type="checkbox"/> 半导体设备和仪器 <input type="checkbox"/> 半导体专用材料 <input type="checkbox"/> 集成电路设计技术 <input type="checkbox"/> 晶圆制造技术 <input type="checkbox"/> 半导体封装技术 <input type="checkbox"/>			
产品或技术的鉴定、 验收评价机构			

<p>参评产品及其简要介绍</p> <p>(300 字以内)</p>	
<p>创新性描述</p> <p>属于原始创新、集成创新和消化吸收创新三种创新形式中的哪一种？并说明创新的部分（800 字以内）</p>	
<p>先进性描述</p> <p>产品或技术在国际、国内同行业中的先进性</p> <p>(300 字以内)</p>	

<p>产品或技术发明专利和自主知识产权情况</p> <p>(300字以内)</p>		
<p>产品(或技术)的应用范围和用户情况、市场前景</p> <p>(800字以内)</p>		
<p>产品的销售量和销售收入(采用该项技术形成的销售收入或技术转让收入)</p> <p>(300字以内)</p>		
<p>申报单位:</p> <p>负责人签字:</p> <p>单位签章: 年 月 日</p>	<p>推荐单位:</p> <p>签章: 年 月 日</p>	

★有关栏目文字超出,可另附页。